Präzisions-Glasbearbeitung unterstützt den Trend zur Heterogenen Integration

Ansprechpartner:
Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90

Durch das Laser Induced Deep Etching (LIDE) für Dünnglas eröffnen sich neue Möglichkeiten

„Mit dem neuen Präzisionsverfahren LIDE ermöglichen wir der Mikrosystemtechnik, das ganze Potenzial von Glas zu nutzen“, erklärte Dr. Roman Ostholt, Vice President LIDE bei LPKF, in einem Vortrag beim 3D Systems Summit 2019 in Dresden. Die Beispiele gingen von Through Glass Vias über Glas Embedding bis zu Glass Capping-Lösungen mit nahezu senkrechten Wänden.

Aufgrund seiner Eigenschaften ist Glas für viele Bereiche des Advanced IC und Wafer Level Packaging einer der interessantesten Werkstoffe. Lange Zeit galt er als sehr schwierig zu bearbeiten. Fertigungsbedingt eingebrachte Oberflächendefekte haben Glas den Ruf eingebracht, anfällig für Sprödbruch zu sein und damit im Packaging bestenfalls für einfache Aufgaben geeignet zu sein. „Dank der Laser Induced Deep Etching Technologie (LIDE) ist es erstmalig möglich, in Gläsern tiefe Mikrostrukturen zu erzeugen, ohne dabei Mikrorisse, Spannungen oder andere Oberflächendefekte hervorzurufen. Die Bearbeitung ist äußerst präzise, der Prozess schnell. Mit dem Einsatz des LIDE-bearbeiteten Glases ist dadurch in der Heterogenen Integration im Bereich Advanced IC- und Wafer Level-Packing noch mehr möglich als bisher.“

Die Informationen aus dem Vortrag zum LIDE-Verfahren und den Möglichkeiten, die sich dadurch für die Mikrosystemtechnik eröffnen, finden sich kompakt zusammengestellt auf der Vitrion Homepage: www.vitrion.com.

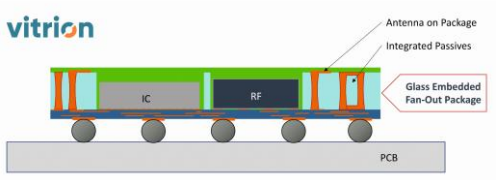

Abb.: Glassubstrat für Fan-Out-Packages mit zusätzlichen Mikrostrukturen (rechts); Glass Embedded Fan-Out Package (links)

LPKF
Laser & Electronics AG
Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.de

Vorstand:
Dr. Götz M. Bendele (CEO)
Christian Witt (CFO)

Aktie:
Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» Weitere Pressemeldungen

Über LPKF

LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme, die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.